

接合強度試験(プル試験・シエア試験)

各種電子部品や半導体パッケージ内に用いられているワイヤ、シンター材、ダイアタッチ材などの接合強度試験(プル試験、シエア試験)が可能です。初期実装評価の他、熱衝撃(温度サイクル)試験やパワーサイクル試験を始めとした長期信頼性試験と組み合わせて、接合強度試験を行うことで得られるデータは、材料選定や不具合解析時の参考になります。

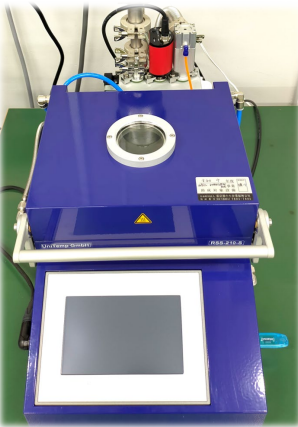
<評価対象例>

金ワイヤ、アルミワイヤ、銅ワイヤ、銅クリップ、ダイアタッチ材、シンタリング材など

さまざまな製品や部品に合わせて試験治具の設計・作製も承っております。

評価したい箇所をプル試験・シエア試験にて接合強度を評価可能です。

また、金・アルミ・銅ワイヤ用のワイヤボンダおよびギ酸リフロー装置を保有しており、対象サンプル表面のワイヤボンディング評価およびダイシエア評価も可能です。



ギ酸リフロー装置



ワイヤボンダ

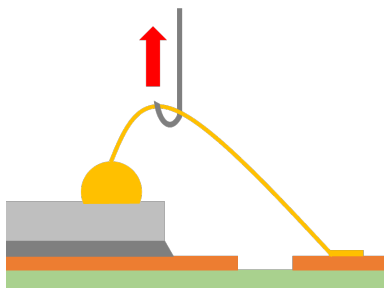


ボンディングテスタ

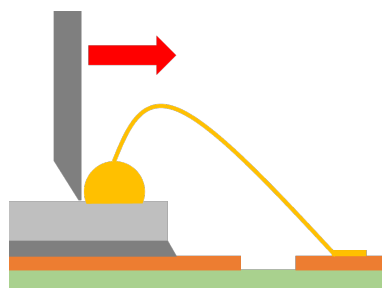
◆装置仕様および代表的な試験モード

最大測定強度: プル 50gf / 2kgf、シエア 500gf / 50kgf

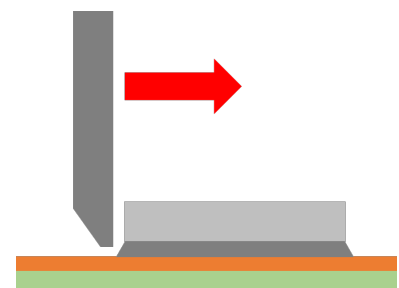
測定速度: プル 1μm/sec~5mm/sec、シエア 1μm/sec~10mm/sec



ワイヤプル試験



ボールシエア試験



ダイシエア試験

◆対応規格

AEC-Q101, AEC-Q101-003, AEC-Q006

AEC-Q100, AEC-Q100-001, AEC-Q100-010, AEC-Q003

MIL-STD-883 Method 2011.7, 2019.5

MIL-STD-750-2 Method 2017, 2037

JESD22-B116, -B117

お問い合わせ先